

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b760m-gaming-plus-wifi-s1700-4ddr5-dp-hdmi-matx-p-311232.html>

Płyta główna B760M GAMING PLUS WIFI s1700 4DDR5 DP/HDMI mATX



Cena brutto	633,99 zł
Cena netto	515,44 zł
Numer katalogowy	KBMSIIIIEB760U08
Kod producenta	B760M GAMING PLUS WIFI
Kod EAN	4711377154017
Liczba gniazd DDR5	4
Gwarancja	36 mc.
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	2
Gniazda rozszerzeń	2 x M.2
Złącza dostępne na płycie	1 x Przedni panel audio
Zintegrowany procesor	Nie
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	6
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	192
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	7
Karta dźwiękowa	Realtek ALC897 Codec 7.1-Channel High Definition Audio
Grafika	2xHDMI Obsługa HDMI 2.1, maksymalna rozdzielczość 4K 60 Hz 2x DisplayPort Obsługa DP 1.4, maksymalna rozdzielczość 4K 60H
Format płyty	micro ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	2x M.2 Źródło M.2_1 (z procesora) obsługuje do PCIe 4.0 x4, obsługuje urządzenia 2280/2260/2242 Źródło M.2_2 (z chipsetu) obsługuje tryb PCIe 4.0 x4 / SATA, obsługuje urządzenia 2280/2260/2242 4xSATA6G
Interfejs sieciowy	Intel Wi-Fi 6E Moduł beprzewodowy jest wstępnie

	zainstalowany w gnieździe M.2 (Key-E). Obsługuje MU-MIMO TX/RX, 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz (160 MHz) do 2,4 Gb/s Obsługuje 802.11 a/b/g/n/ac/ax Obsługuje Bluetooth 5.3, FIPS, FISMA
Częstotliwość szyny pamięci	6800 MHz
Rodzaj pamięci	DDR5
Model	Płyta główna B760M Gaming Plus WiFi
Złącza zewnętrzne	2 x USB 3.1
RAID	Tak
Chipset	Intel B760
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Wymiary	243.84 x 243.84 mm
Rodzina procesora	Intel Celeron

Opis produktu

Płyta główna B760M Gaming Plus WiFi

- Obsługa procesorów Intel Core 14./13./12. generacji, procesorów Intel Pentium Gold i Celeron dla gniazda LGA 1700
- Obsługuje pamięć DDR5, dwukanałowy DDR5 6800+MHz (OC)
- Ulepszona konstrukcja zasilania: system zasilania Duet Rail 12+1 z P-PAK, 8-pinowe + 4-pinowe złącza zasilania procesora, wzmocnienie rdzenia, zwiększenie pamięci
- Rozwiązanie termiczne klasy premium: rozszerzony radiator, podkładki termiczne MOSFET o mocy 7 W/mK, dodatkowe podkładki termiczne dławikowe zapewniają wysoką wydajność systemu i nieprzerwane wrażenia z gry
- Błyskawiczne wrażenia z gry: gniazdo PCIe 4.0, złącze Lightning Gen 4 x4 M.2 z M.2 Shield Frozr, USB 3.2 Gen 2 10G
- Rozwiązanie LAN 2,5G z Wi-Fi 6E: Ulepszone rozwiązanie sieciowe do zastosowań profesjonalnych i multimedialnych. Zapewnia bezpieczne, stabilne i szybkie połączenie sieciowe
- Wysokiej jakości PCB: 6-warstwowa płytka drukowana wykonana z miedzi pogrubionej o grubości 2 uncji
- Wzmocnienie dźwięku: Nagradzaj swoje uszy studyjną jakością dźwięku, aby uzyskać najbardziej wciągające wrażenia z gry.